

导电胶

一、环氧导电胶

环氧导电胶是由高粘接强度的环氧胶和高导电的银颗粒巧妙地组合在一起。具有室温固化、粘接强度高、导电温度性优宽范围、操纵简便等多项优点。

应用：金属与金属粘接、印刷线路板线路连接、微波元器件引线连接、金属丝网屏蔽条粘接
使用方法：10 克以下的导电胶，去掉配制好的双组份的隔挡，混合均匀既可使用。85 可以以上的导电胶，需与固化挤按重量 100：6.3 配比，混合均匀既可使用。

技术参数：

体电阻：0.002Ω

粘接剪切强度：84kg/cm²

工作温度：-55℃~125℃

操作时间：30 分钟

温室固化时间（25℃）：24 小时

高温固化时间（113℃）：15 分钟

存贮期：3 年

涂覆面积：156cm²/g



二、硅脂导电胶

硅脂导电胶是在利用硅脂的高粘性和金属颗粒的高导电巧妙结合成的。依据组成成份，可分单组份和双组份；依据填充的导电颗粒可分为填银硅脂胶、填镍硅脂胶、铜镀银硅脂胶、铝镀银硅脂胶、石墨镀镍导电胶等。

其中 1030 是一种成分 RTV 硅酮，它暴露在中等潮湿环境下固化，具有 2 倍与其他 RTV 硅酮的撕裂强度和 200psi (1.38MPa) 的搭接剪切强度。为了最高的导电率，粘合层厚度不应超过 10mil。为了正确的固化，宽度不应该超过 0.5in (1.27cm)。材料在 1-2psi (0.01Mpa) 标准压力和不超过 66℃ 的温度下固化。

应用：导电橡胶板与金属粘接、导电橡胶条与金属粘接

使用方法：一定要将需要粘接的表面清洗干净后，后按规定操作。

技术参数：

体电阻：0.05Ω

剥离强度：14Kg/cm²

工作温度：-55℃~200℃

操作时间：30 分钟

温室固化时间：7 天

存储期：6 个月

粘接面积：18.5cm²/g

胶粘接厚度：小于等于 0.03mm

包装：114 克/套



三、技术规格列表

CHO-BOND Adhesive	584-29	584-208	1029	1030	1085	1086
粘合剂	环氧树脂	环氧树脂	硅铜	硅铜	底剂, 用于 1029	底剂, 用于 1030, 1075
填料	Ag	Ag	Ag/Cu	Ag/Cu		
最小重量比	100:6.3	1: 1	1.0: 2.5	单成分	单成分	单成分
稠粘度	稠糊剂	中等稠剂	稠糊剂	含砂糊剂	稀流体	稀流体
表现比	2.5±0.20	2.7±0.20	3.0±0.35	3.75±0.55	0.87±0.15	0.75±0.10
最小重叠剪切强度 Psi (Mpa)	1200 (8.28)	700 (4.83)	450 (3.11)	200 (1.38)	不适合	不适合
最大 DC 体积电阻率 ohm-cm	0.0	0.05	0.06*	0.05	不适合	不适合
使用温度	-55~125°C	-62~99°C	-55~125°C	-55~200°C	-80~200°C	-80~200°C
高温固化周期	0.25hr. @ 113°C	0.75hr. @100°C	0.5hr. @121°C	不适合	不适合	不适合
室温固化时间	24hrs	24hrs	1wk**	1wk**	0.5hr	0.5hr
使用期	0.5hr	1.0hr	2.0hr	0.5hr	不适合	不适合
储存期限 (月)	9	9	6	6	6	6
覆盖范围	1100 (156.1)	1000 (141.9)	1800 (25.5)	1300 (18.5)	不适合	不适合
推荐的厚度 in. (cm)	0.001 min (0.03)	0.001 min (0.03)	0.008 max. (0.03)	0.10 max. (0.03)	0.0002 max. (0.001)	0.0002 max. (0.001)